

# 2022-2028年中国键合丝行业市场全景分析及发展趋势研究报告

报告大纲

## 一、报告简介

智研咨询发布的《2022-2028年中国键合丝行业市场全景分析及发展趋势研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/202103/936867.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

智研咨询发布的《2022-2028年中国键合丝行业市场全景分析及发展趋势研究报告》共九章。首先介绍了键合丝行业市场发展环境、键合丝整体运行态势等，接着分析了键合丝行业市场运行的现状，然后介绍了键合丝市场竞争格局。随后，报告对键合丝做了重点企业经营状况分析，最后分析了键合丝行业发展趋势与投资预测。您若想对键合丝产业有个系统的了解或者想投资键合丝行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

### 第一章 半导体的引线键合材料——键合丝概述

#### 1.1 键合内引线材料

##### 1.1.1 半导体的引线键合技术发展

##### 1.1.2 引线键合技术(WB)

##### 1.1.3 载带自动键合技术(TAB)

##### 1.1.4 倒装焊技术(FC)

#### 1.2 键合丝及其在半导体封装中的作用

##### 1.2.1 键合丝定义及作用

##### 1.2.2 键合丝在半导体封装中的作用

#### 1.3 键合丝的主要品种

### 第二章 键合丝行业特点及应用市场的概述

#### 2.1 世界半导体封装用键合丝行业发展概述

#### 2.2 键合金属丝的应用领域

#### 2.3 封装用键合丝行业的发展特点

##### 2.3.1 键合丝是半导体封装中不可缺少的重要基础材料

##### 2.3.2 产品与常规焊接材料有所不同

##### 2.3.3 键合丝行业进步与半导体发展关系密不可分

##### 2.3.4 键合丝行业内驱于更加激烈的竞争

##### 2.3.5 产品品种多样化特点

##### 2.3.6 键合丝应用市场的新变化

#### 2.4 当前世界及我国键合丝行业面临的问题

##### 2.4.1 原材料成本的提高

##### 2.4.2 新品研发的加强

#### 2.4.3 知识产权的问题越发突出

#### 2.4.4 国内市场价格竞争更趋恶化

### 第三章 键合丝的品种、性能与制造技术

#### 3.1 键合丝的品种及各品种的性能对比

#### 3.2 键合丝的性能要求

##### 3.2.1 理想的引线材料应具备的性能特点

##### 3.2.2 对键合金丝的性能要求

##### 3.2.3 对键合丝的表面性能要求

##### 3.2.4 对键合丝的线径要求

#### 3.3 键合丝的主要行业标准

#### 3.4 键合金丝的主要品种

##### 3.4.1 按用途及性能划分

##### 3.4.2 按照键合要求的弧度高低划分

##### 3.4.3 按照键合不同封装形式划分

##### 3.4.4 按照键合丝应用的不同弧长度划分

#### 3.5 键合金丝的生产工艺过程

##### 3.5.1 键合金丝制备的工艺流程

##### 3.5.2 影响金丝在键合过程中可靠性的因素

##### 3.5.3 加入微量元素进行调节键合丝的性能

#### 3.6 键合金丝生产用原料高纯金的制备

#### 3.7 键合金丝未来的发展方向

### 第四章 世界及我国键合金丝市场现状

#### 4.1 世界键合丝市场规模情况

#### 4.2 世界不同类型的键合丝市场比例变化

#### 4.3 世界键合金丝的产销量及其市场格局

##### 4.3.1 世界键合金丝的产销量及其市场格局

##### 4.3.2 世界键合铜丝市场的需求情况与格局变化

#### 4.4 我国键合丝市场需求量情况

#### 4.5 我国国内键合金丝市场需求量情况

##### 4.5.1 我国国内键合金丝市场规模变化

##### 4.5.2 我国国内键合金丝的市场格局

#### 4.6 我国键合铜丝的市场需求情况

### 第五章 键合铜丝的特性及品种

#### 5.1 键合铜丝产品的发展

##### 5.1.1 键合铜丝将成为IC封装引线键合的主要键合丝品种

### 5.1.2 键合铜丝发展历程

### 5.1.3 制造技术进步推动了键合铜丝市场扩大及格局的改变

## 5.2 键合铜丝的特性

### 5.2.1 键合铜丝与其它键合丝主要性能对比

### 5.2.2 键合铜丝的成本优势

### 5.2.3 键合铜丝的性能优势

## 5.3 国外主要企业的键合铜丝产品品种及性能

### 5.3.1 国外键合铜丝产品发展概述

### 5.3.2 田中贵金属公司的四种产品

### 5.3.3 新日铁公司的覆Pd 键合铜丝

### 5.3.4 贺利氏公司的五种键合铜丝产品

### 5.3.5 MEK电子公司的三种键合铜丝产品

## 5.4 我国半导体键合用铜丝标准介绍

### 5.4.1 标准编制的经过

### 5.4.2 标准中主要技术指标

## 第六章 键合铜丝的制造工艺过程及其产品知识产权情况

### 6.1 键合铜丝的制造工艺流程简述

## 6.2 键合铜丝制造的具体工艺环节

### 6.2.1 坯料铸造

### 6.2.2 成丝加工

### 6.2.3 热处理

### 6.2.4 复绕（卷线）

## 6.3 键合铜丝制造过程中的质量影响因素

### 6.3.1 工艺过程控制对键合铜丝的质量影响

### 6.3.2 键合铜丝的组织与微结构对其质量影响

## 6.4 镀钯键合铜丝的特性及其生产工艺过程

### 6.4.1 研发、生产镀钯键合铜丝的重要意义

### 6.4.2 镀钯键合铜丝的工艺流程

### 6.4.3 镀钯键合铜丝的工艺特点

## 6.5 键合铜丝知识产权情况

### 6.5.1 世界及我国键合铜丝专利情况

### 6.5.2 新日铁公司实施专利战略的情况

## 第七章 键合金丝、键合铜丝的三大应用市场领域现况与发展预测

### 7.1 键合丝应用市场之一 —— 半导体封测市场现况与发展

#### 7.1.1 世界半导体封测产业概况及市场

## 7.1.2 我国半导体封测产业现状及发展

### 7.1.2.1 国内IC封装测试业生产现状

### 7.1.2.2 国内IC封测厂商的分布及产能

### 7.1.2.3 国内IC封装测试业销售收入前30家企业情况

### 7.1.2.4 国内IC封装测试业在技术上进步

## 7.1.3 国内IC封装测试业的发展趋势与展望

## 7.2 键合丝应用市场之二 —— 我国分立器件及其封测产业的生产概况及市场

### 7.2.1 我国分立器件市场现状

### 7.2.2 国内分立器件生产企业情况

### 7.2.3 国内分立器件产业发展前景展望

## 7.3 键合丝应用市场之三 —— 我国LED封装产业的生产概况及市场

### 7.3.1 键合丝在LED封装中的应用

#### 7.3.1.1 键合丝在LED封装制造中的功效

#### 7.3.1.2 焊线压焊的工艺流程

### 7.3.2 我国LED封装产业现状

### 7.3.3 我国LED封装企业分布情况

### 7.3.4 我国LED封装产业规模情况

### 7.3.5 我国LED封装产业2022-2028年发展的预测与分析

## 第八章 世界键合丝生产现状及其主要生产企业现状

### 8.1 世界键合丝产业的变化与现状

### 8.2 世界键合丝主要生产厂家概述与现状分析

#### 8.2.1 世界键合丝的主要生产厂家概述

#### 8.2.2 近年世界各国/地区键合金丝生产企业的变化分析

##### 8.2.2.1 日本键合丝生产企业

##### 8.2.2.2 欧美企业贺利氏集团

##### 8.2.2.3 韩国键合丝生产企业

### 8.3 世界键合丝的主要生产厂家及其产品情况

#### 8.3.1 田中贵金属株式会社

#### 8.3.2 贺利氏集团

## 第九章 我国国内键合铜丝的主要生产企业及其产品情况

### 9.1 国内键合丝产业发展概述

#### 9.1.1 国内键合丝行业总况

#### 9.1.2 国内键合丝生产企业的现状

#### 9.1.3 国内键合丝生产企业地区分布情况

### 9.2 国内键合铜丝行业的生产情况

### 9.2.1 国内键合铜丝生产发展概述

## 9.3 国内键合丝的主要生产厂家及其产品情况

### 9.3.1 贺利氏招远（常熟）电子材料有限公司

### 9.3.2 宁波康强

### 9.3.3北京达博

### 9.3.4烟台招金励福

### 9.3.5昆明贵研铂业

### 9.3.6广州佳博

### 9.3.7成都长城精练

### 9.3.8贺利氏招远贵金属材料有限公司

### 9.3.9杭州菱庆高新材料有限公司

### 9.3.10上海住友金属矿山电子材料有限公司

### 9.3.11 四川威纳尔特种电子材料有限公司

## 9.4 国内其它新建、在建的键合丝生产厂家情况

### 9.4.1广州佳博金丝科技有限公司

### 9.4.2合肥煜立电子科技有限公司（ZY KT）

部分图表目录：

图表 1 键合丝作为键合内引线的IC封装结构

图表 2 键合丝主要种类与产品的形态

图表 3 键合丝产品的包装状态

图表 4 常用键合金丝的力学性能

图表 5 键合银丝的室温机械性能

图表 6 高纯金的制备工艺流程

图表 7 2017-2021年全球键合丝行业市场规模分析

图表 10 2017-2021年全球键合铜丝行业需求分析

图表 11 2017-2021年我国键合丝行业需求分析

图表 12 2017-2021年我国键合金丝行业市场规模分析

图表 13 2021年我国键合金丝行业竞争格局分析

图表 14 2017-2021年我国键合铜丝行业市场需求分析

图表 15 键合铜丝与金丝的力学性质比较

图表 16 键合铜丝取向成像图

图表 17 镀钯键合铜丝的工艺流程

图表 18 镀钯键合铜丝浸镀工艺流程

图表 19 2017-2021年国内IC封装测试业销售收入

图表 20 2017-2021年国内IC封装测试业统计表

图表 21 2017-2021年国内封装测试企业地域分布情况

图表 22 2017-2021年国内IC封装测试业统计

图表 23 2021年国内IC封装测试企业地域分布

图表 24 2021年国内IC封测业收入排名前10企业

图表 25 2021年国内IC封测业前10企业销售额占比

图表 26 2021年国内IC封测业收入排名前11-30企业

图表 27 入选2021年中国半导体创新产品和技术IC封装与测试技术

图表 28 2021年全国半导体分立器件产量分省市统计表

图表 29 2021年中国LED封装企业区域数量分布（单位：%）

图表 30 2021年中国主要城市LED封装企业数量比较分析（单位：%）

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/202103/936867.html>